

## (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局(43)国際公開日  
2004年12月9日 (09.12.2004)

PCT

(10)国際公開番号  
WO 2004/107444 A1

(51)国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 27/04

(21)国際出願番号: PCT/JP2003/006780

(22)国際出願日: 2003年5月29日 (29.05.2003)

(25)国際出願の言語: 日本語

(26)国際公開の言語: 日本語

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 三菱電機株式会社 (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 Tokyo (JP)

(72)発明者: および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 西川 和康 (NISHIKAWA,Kazuyasu) [JP/JP]; 〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三菱電機株式会社

(74)代理人: 田澤 博昭, 外 (TAZAWA,Hiroaki et al.); 〒100-0013 東京都千代田区霞が関三丁目7番1号 大東ビル7階 Tokyo (JP)

(81)指定国(国内): CN, JP, US.

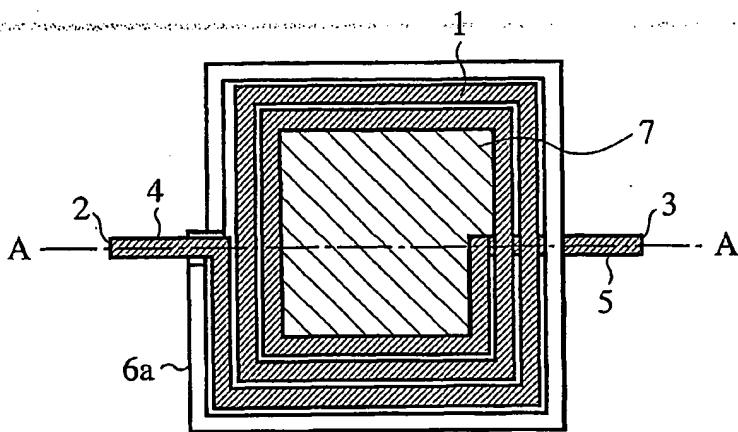
(84)指定国(広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

添付公開書類:  
— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

(54) Title: SEMICONDUCTOR DEVICE

(54)発明の名称: 半導体装置



WO 2004/107444 A1

周に沿って設けた一部を開放した一連続の導体配線からなり、接地電位と電気的に接続するシールド(6a)とを備える半導体装置。

(57) Abstract: A semiconductor device comprises an inductor (1) where a conductive wiring is formed in a spiral shape on a semiconductor substrate (10) and comprises a continuous conductive wiring which is provided along the outside periphery of the spiral pattern of the inductor (1) and part of which is opened. The device is provided with a shield (6a) electrically connected to ground potential.

(57) 要約: 半導体基板 (10) 上に導体配線を渦巻き状に形成してなるインダクタ (1) と、インダクタ (1) の渦巻きパターンの外

BEST AVAILABLE COPY